

**Вопросы к зачёту по учебной дисциплине архитектура и технология  
сверхбольших интегральных схем (3 семестр)**

зачету, экзамену

полное наименование

1. Сверхвысокая степень интеграции и геометрический фактор
2. Физические шкалы, описывающие работу современных СБИС
3. Чистые производственные помещения
4. Выращивание полупроводниковых кристаллов и формирование полупроводниковых пластин
5. Диффузия в полупроводниках
6. Ионная имплантация в полупроводниках
7. Отжиг имплантированных структур
8. Окисление и осаждение тонких пленок элементов
9. Методы формирования металлических пленок
10. Литографические процессы
11. Травление
12. Корпусирование СБИС
13. Биполярные структуры
14. КМОП-структуры
15. Гетероэпитаксиальные структуры
16. Гомоэпитаксиальные структуры
17. Склеивание пластин кремния и обратное травление
18. Основные направления развития структур КНИ
19. Трёхмерная интеграция
20. Постоянная память
21. Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ)
22. Новые материалы для производства СБИС